

盛合晶微半导体有限公司
(SJ Semiconductor Corporation)

首次公开发行股票科创板
上市公告书提示性公告

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）（以下简称“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（证券时报网，网址 www.stcn.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；金融时报网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn），并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司、联席主承销商中信证券股份有限公司的住所，供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：盛合晶微
- （二）扩位简称：盛合晶微
- （三）股票代码：688820

(四) 首次公开发行后总股本: 186,277.4097 万股

(五) 首次公开发行股份数量: 25,546.6162 万股, 本次发行全部为新股, 无老股转让。

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险, 提醒投资者充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下:

(一) 涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》(上证发〔2023〕32号), 科创板股票交易实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二) 流通股数量较少的风险

上市初期, 原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月, 保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司股票上市之日24个月, 公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划限售期为36个月, 其他战略配售投资者本次获配股票的限售期为12个月, 网下投资者最终获配股份数量的10%限售期为6个月。本次发行后总股本为186,277.4097万股, 其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为17,290.2643万股, 占本次发行后总股本的比例为9.28%。公司上市初期流通股数量相对较少, 存在流动性不足的风险。

(三) 与行业可比上市公司估值水平比较

本次发行价格为19.68元/股, 此价格对应的市盈率为:

(1) 148.05倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2) 168.79倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

(3) 171.58 倍 (每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)；

(4) 195.62 倍 (每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)；

结合发行人经营模式以及可比公司估值情况等维度,本次发行同时披露可以反映发行人行业特点的市净率。

本次发行价格对应的市净率为:

(1) 2.33 倍 (每股净资产按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股数计算)；

(2) 2.00 倍 (每股净资产按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

根据国家统计局《国民经济分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截至 2026 年 4 月 3 日,中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”最近一个月平均静态市盈率为 62.61 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价(元/股)	T-3 日总市值(亿元)	2024 年 12 月 31 日归母净资产(亿元)	2024 年扣非前 EPS(元/股)	2024 年扣非后 EPS(元/股)	2024 年静态市盈率(扣非前)(倍)	2024 年静态市盈率(扣非后)(倍)	2024 年市净率(倍)
600584.SH	长电科技	38.29	685.17	276.19	0.8995	0.8649	42.57	44.27	2.48
002156.SZ	通富微电	40.42	613.41	146.91	0.4465	0.4093	90.53	98.76	4.18

002185.SZ	华天科技	11.36	371.05	166.59	0.1887	0.0102	60.21	1,110.29	2.23
688362.SH	甬矽电子	38.02	156.07	25.11	0.1616	-0.0617	235.30	-	6.22
688352.SH	颀中科技	11.87	141.14	60.03	0.2635	0.2327	45.05	51.01	2.35
688372.SH	伟测科技	133.40	223.80	26.19	0.7643	0.6426	174.53	207.58	8.54
603005.SH	晶方科技	26.66	173.87	42.76	0.3876	0.3320	68.79	80.30	4.07
算术平均值（剔除异常值）							102.43	96.39	4.29

数据来源：Ifind，数据截至 2026 年 4 月 3 日（T-3 日）；

注 1：市盈率及市净率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2024 年扣非前/后 EPS=2024 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日总股本。

注 3：甬矽电子 2024 年市盈率（扣非后）为负值和华天科技 2024 年市盈率（扣非后）为极值，均予以剔除。

本次发行价格 19.68 元/股，对应的发行人 2024 年市净率（每股净资产用按照 2024 年度经审计的归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）为 2.00 倍，低于同行业可比公司 2024 年平均静态市净率 4.29 倍。本次发行价格对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 195.62 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司 2024 年扣除非经常性损益后的平均静态市盈率 96.39 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

发行人：盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）

法定代表人：崔东

联系地址：江苏省无锡市江阴市东盛西路9号

联系人：周燕

电话：0510-86975899

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：资本市场部

电话：010-65051166

联席主承销商：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

电话：0755-23835515、0755-23835516

发行人：盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2026年4月20日

（此页无正文，为《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）
首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

发行人：盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）



2026年4月20日

（此页无正文，为《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2026年4月20日

(此页无正文，为《盛合晶微半导体有限公司 (SJ Semiconductor Corporation)
首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司

